



Product Specification

XBLW MAX485EB

3V - 5 V 供电，256 节点，2.5Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器

WEB | www.xinboleic.com

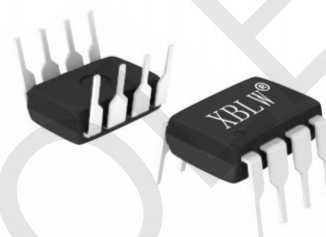


描述

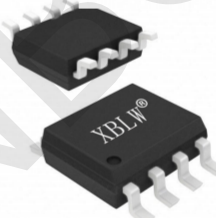
MAX485是一款3.3V供电、半双工、低功耗，功能完全满足TIA/EIA-485 标准要求的RS-485 收发器。MAX485包括一个驱动器和一个接收器，两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时，驱动器与接收器均输出高阻态。MAX485具有 1/8 负载，允许256个MAX485收发器并接在同一通信总线上。可实现高达2.5Mbps 的无差错数据传输。
MAX485工作电压范围为3.0~5V，具备失效安全（fail-safe）、过温保护、限流保护、过压 保护等功能。

特点

- 3-5V电源供电，半双工；
- 1/8单位负载，允许最多256个器件连接到总线；
- 驱动器短路输出保护；
- 过温保护功能；
- 低功耗关断功能；
- 接收器开路失效保护；
- 具有较强的抗噪能力；
- 集成的瞬变电压抵制功能；
- 在电噪声环境中的数据传输速率可达到2.5Mbps；



DIP-8

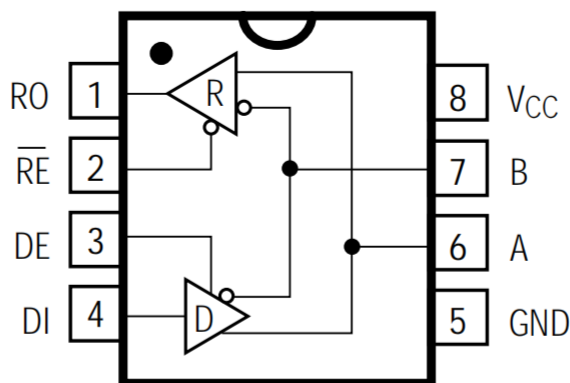


SOP-8

订购信息

产品型号	封装	丝印	包装	包装数量	备注
XBLW MAX485EBDTR	SOP-8	485EB	编带	2500只/盘	
XBLW MAX485EEDTR	SOP-8	485EE	编带	2500只/盘	ESD
XBLW MAX485EBN	DIP-8	MAX485EBN	管装	2000只/盒	
XBLW MAX485EEN	DIP-8	MAX485EEN	管装	2000只/盒	ESD
XBLW MAX485EEMDTR	MSOP-8	X485EM	编带	3000只/盘	ESD

引脚分布图



引脚定义

图 1 MAX485引脚分布图

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	RO	接收器输出端。 当 $\overline{RE}$ 为低电平时，若 $A-B \geq 200mV$ ，RO 输出为高电平；若 $A-B \leq -200mV$ ，RO 输出为低电平。
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能控制。 当 $\overline{RE}$ 接低电平时，接收器输出使能，RO 输出有效；当 $\overline{RE}$ 接高电平时，接收器输出禁能，RO 为高阻态； RE接高电平且DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
3	DE	驱动器输出使能控制。 DE 接高电平时驱动器输出有效，DE 为低电平时输出为高阻态； $\overline{RE}$ 接高电平且DE 接低电平时，器件进入低功耗关断模式。
4	DI	DI 驱动器输入。DE 为高电平时，DI 上的低电平使驱动器同相端A 输出为低电平，驱动器反相端B 输出为高电平；DI 上的高电平将使同相端输出为高电平，反相端输出为低。
5	GND	接地
6	A	接收器同相输入和驱动器同相输出端
7	B	接收器反相输入和驱动器反相输出端
8	Vcc	接电源

极限参数

参数	符号	数值	单位
电源电压	Vcc	+7	V
控制端口电压	$\overline{RE}$, DE, DI	-0.5 ~ +7	V
总线侧输入电压	A、B	-8 ~ +12.5	V
接收器输出电压	RO	-0.5 ~ +7	V
工作温度范围	T _A	-40 ~ + 85	°C
存储工作温度范围	T _{stg}	-60 ~ + 150	°C
焊接温度范围		300	°C
连续功耗	SOP8	400	mW
	DIP8	700	mW

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

驱动器直流电学特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出 (无负载)	V_{OD1}			3.3		V
驱动差分输出	V_{OD2}	图 2, $R_L = 54 \Omega$	1.5	3.3	V_{CC}	V
		图 2, $R_L = 100 \Omega$			V_{CC}	
输出电压幅值的变化 (NOTE1)	ΔV_{OD}	图 2, $R_L = 54 \Omega$			0.2	V
输出共模电压	V_{OC}	图 2, $R_L = 54 \Omega$			3	V
共模输出电压幅值的变化 (NOTE1)	ΔV_{OC}	图 2, $R_L = 54 \Omega$			0.2	V
高电平输入	V_{IH}	DE, DI, $\overline{RE}$	2.0			V
低电平输入	V_{IL}	DE, DI, $\overline{RE}$			0.8	V
逻辑输入电流	I_{IN1}	DE, DI, $\overline{RE}$	-1		1	μA
输出短路时的电流, 短路到高	I_{OSD1}	短路到 0V~12V			250	mA
输出短路时的电流, 短路到低	I_{OSD2}	短路到-7V~0V	-250			mA
过温关断阈值温度				140		$^{\circ}C$
过温关断迟滞温度				20		$^{\circ}C$

(如无另外说明, $V_{CC}=3.3V\pm 10\%$, $Temp=T_{MIN}\sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$) NOTE1:
 ΔV_{OD} 和 ΔV_{OC} 分别是输入信号 DI 状态变化时引起的 V_{OD} 与 V_{OC} 幅值的变化。

接收器直流电学特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
输入电流 (A, B)	I_{IN2}	DE = 0 V, $V_{CC}=0$ 或 3.3V $V_{IN} = 12 V$			125	μA
		DE = 0 V, $V_{CC}=0$ 或 3.3V $V_{IN} = -7 V$	-100			μA
正向输入阈值电压	V_{IT+}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$			+200	mV
反向输入阈值电压	V_{IT-}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	-200			mV
输入迟滞电压	V_{hys}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	10	30		mV
高电平输出电压	V_{OH}	$I_{OUT} = -2.5mA$, $V_{ID} = +200 mV$	$V_{CC}-1.5$			V
低电平输出电压	V_{OL}	$I_{OUT} = +2.5mA$, $V_{ID} = -200 mV$			0.4	V
三态输入漏电流	I_{OZR}	$0.4 V < V_O < 2.4 V$			± 1	μA
接收端输入电阻	R_{IN}	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	96			$k\Omega$
接收器短路电流	I_{OSR}	$0 V \leq V_O \leq V_{CC}$	± 8		± 60	mA

(如无另外说明, $V_{CC}=3.3V\pm 10\%$, $Temp=T_{MIN}\sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$)

供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电电流	I_{CC1}	$\overline{RE}=0V, DE=0V$		520	800	μA
	I_{CC2}	$\overline{RE}=V_{CC}, DE=V_{CC}$		540	700	μA
关断电流	I_{SHDN}	$\overline{RE}=V_{CC}, DE=0V$		0.5	10	μA

驱动器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
驱动器差分输出延迟	t_{DD}	$R_{DIFF} = 60 \Omega,$ $C_{L1}=C_{L2}=100pF$ (见图3 与图4)		10	35	ns
驱动器差分输出过渡时间	t_{TD}			12	25	ns
驱动器传播延迟从低到高	t_{PLH}	$R_{DIFF} = 27 \Omega,$ (见图3 与图4)		8	35	ns
驱动器传播延迟从高到低	t_{PHL}			8	35	ns
$ t_{PLH}-t_{PHL} $	t_{PDS}			1	8	ns
使能到输出高	t_{PZH}	$R_L = 110 \Omega,$ (见图5、6)		20	90	ns
使能到输出低	t_{PZL}			20	90	ns
输入低到禁能	t_{PLZ}	$R_L = 110 \Omega,$ (见图5、6)		20	80	ns
输入高到禁能	t_{PHZ}			20	80	ns
关断条件下, 使能到输出高	t_{DSH}	$R_L = 110 \Omega,$ (见图5、6)		500	900	ns
关断条件下, 使能到输出低	t_{DSL}	$R_L = 110 \Omega,$ (见图5、6)		500	900	ns

接收器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器输入到输出传播延迟从低到高	t_{RPLH}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		80	150	ns
接收器输入到输出传播延迟从高到低	t_{RPHL}			80	150	ns
$ t_{RPLH} - t_{RPHL} $	t_{RPDS}			7	10	ns
使能到输出低时间	t_{RPZL}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		20	50	ns
使能到输出高时间	t_{RPZH}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		20	50	ns
从输出低到 禁能时间	t_{PRLZ}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		20	45	ns
从输出高到 禁能时间	t_{PRHZ}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		20	45	ns
关断状态下 使能到输出高时间	t_{RPSH}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		200	1400	ns
关断状态下 使能到输出低时间	t_{RPSL}	$C_L=15pF$ 见图7 与图8		200	1400	ns
进入关断状态时间	t_{SHDN}	NOTE2	80		300	ns

NOTE2: 当 $\overline{RE}=1$, $DE=0$ 持续时间小于80ns 时, 器件必不进入shutdown 状态, 当大于300ns 时, 必定进入shutdown 状态。

功能表

发送功能表

控制		输入	输出	
$\overline{RE}$	DE	DI	A	B
X	1	1	H	L
X	1	0	L	H
0	0	X	Z	Z
1	0	X	Z(shutdown)	

X: 任意电平; Z: 高阻。

接收功能表

控制		输入	输出
$\overline{RE}$	DE	A-B	RO
0	X	$\geq 200\text{mV}$	H
0	X	$\leq -200\text{mV}$	L
0	X	开/短路	H
1	X	X	Z

X: 任意电平; Z: 高阻。

测试电路

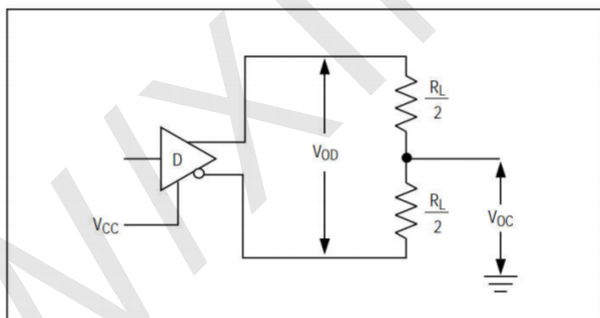
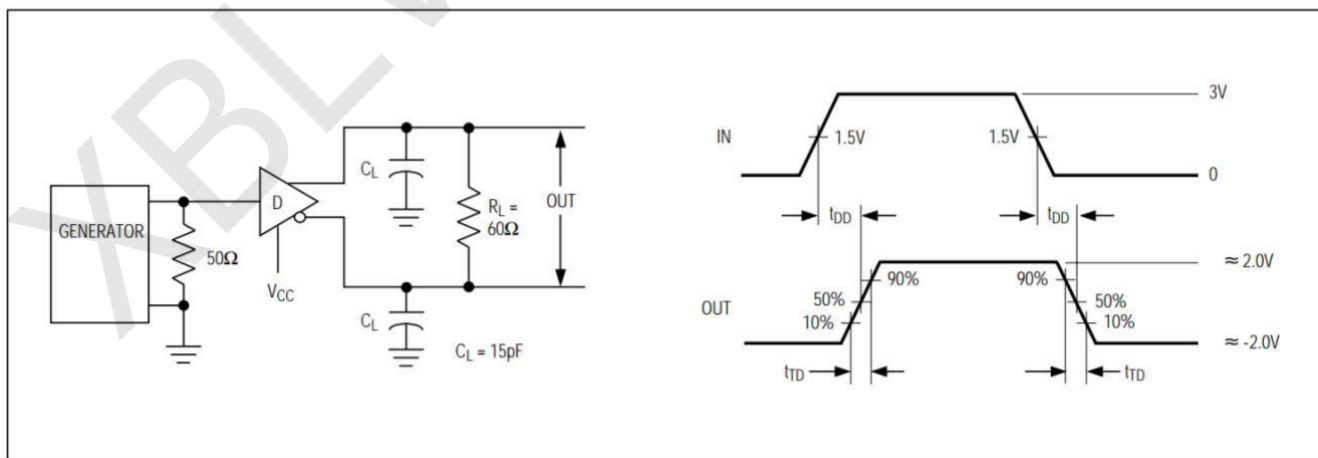


图 2 驱动器直流测试负载



CL 包含探针以及杂散电容（下同）

图 3 驱动器差分延迟与渡越时间

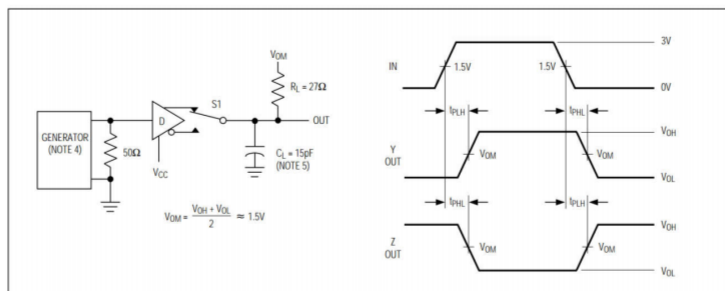


图 4 驱动器传播延迟

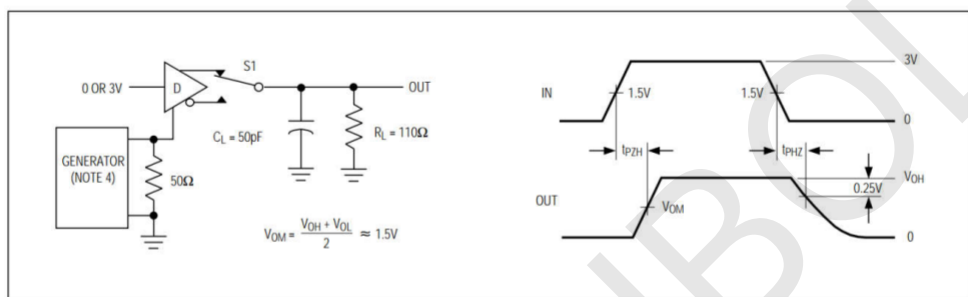


图 5 驱动器使能与禁能时间

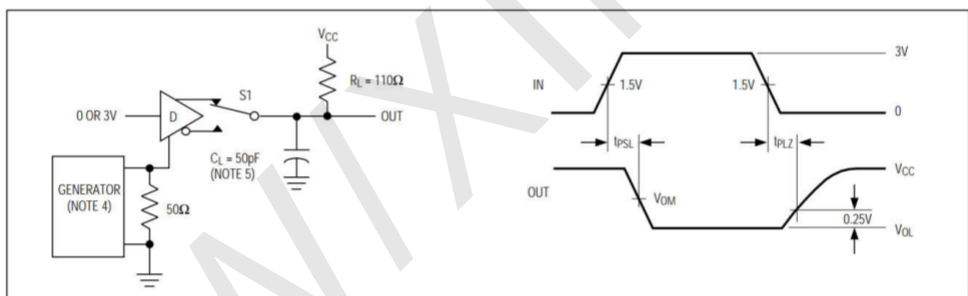


图 6 驱动器使能与禁能时间

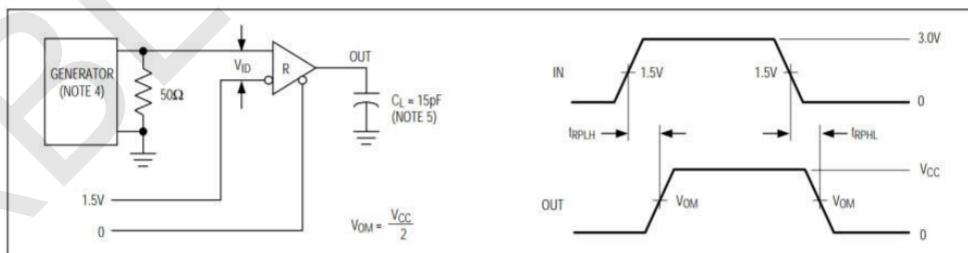


图 7 接收器传播延时测试电路

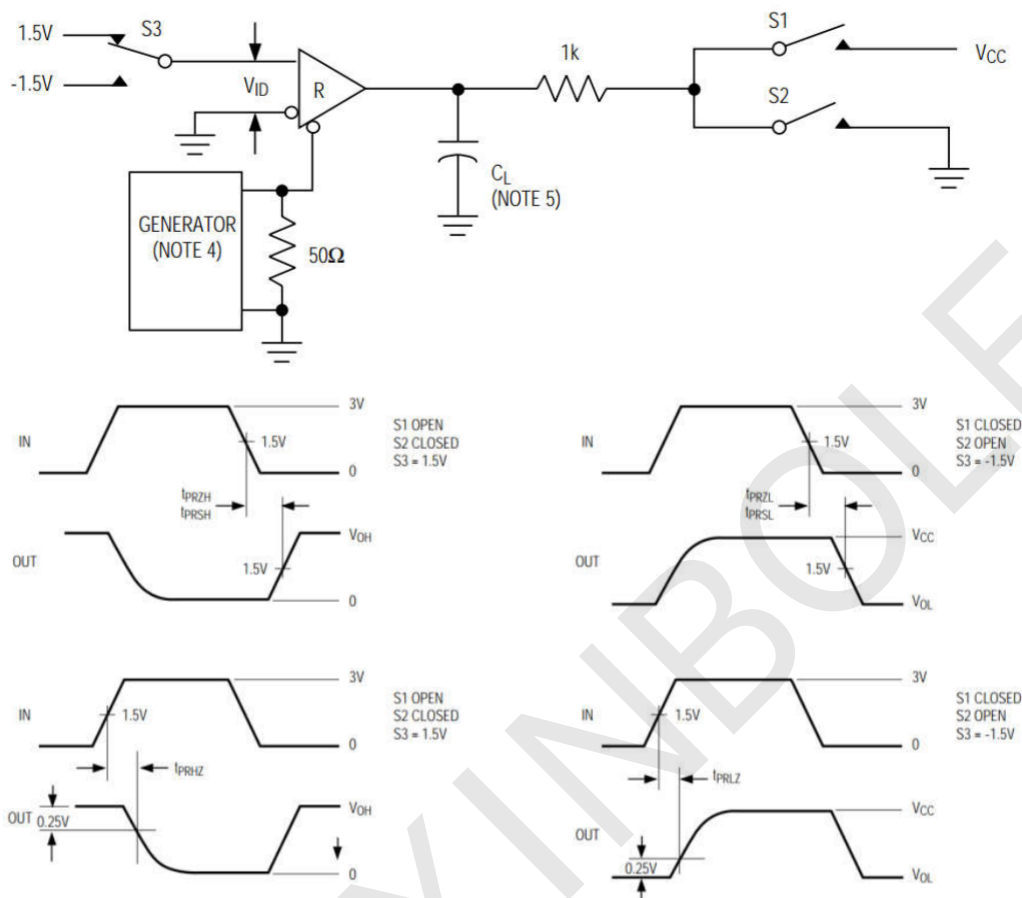


图 8 接收器使能与禁能时间

产品说明

简述

MAX485是用于RS-485/RS-422 通信的半双工高速收发器, 包含一个驱动器和接收器。具有失效安全, 过压保护、过流保护、过热保护功能。MAX485实现高达2.5Mbps 的无差错数据传输。

总线上挂接256个收发器

标准RS485 接收器的输入阻抗为12kΩ(1 个单位负载), 标准驱动器可最多驱动32 个单位负载。MAX485收发器的接收器具有1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ), 允许最多256 个收发器并行挂接在同一通信总线上。这些器件可任意组合, 或者与其它RS485 收发器进行组合, 只要总负载不超过32 个单位负载, 都可以挂接在同一总线上。

驱动器输出保护

通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一, 过流保护, 在整个共模电压范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。第二, 热关断电路, 当管芯温度超过140°C 时, 强制驱动器输出进入高阻状态。

典型应用

总线式组网: MAX485RS485 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图9 显示了典型网络应用电路。这些器件也能用作电缆长于4000 英尺的线性转发器, 为减小反射, 应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配, 主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

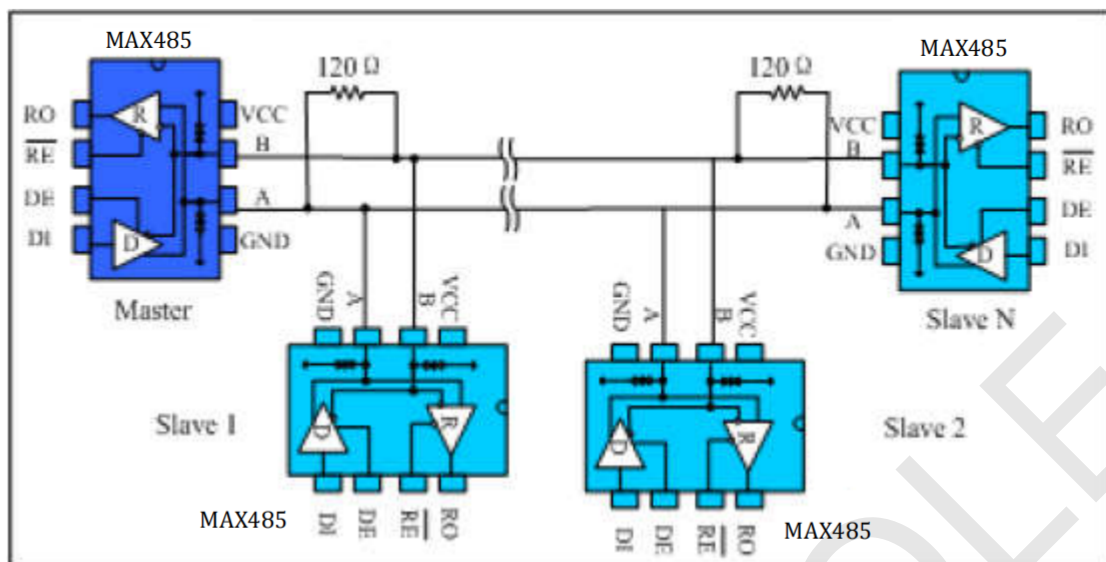


图9 总线式RS485 半双工通讯网络

手拉手式组网：又称菊花链拓扑结构，是RS485 总线布线的标准及规范，是TIA 等组织推 荐使用的RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式，如 图 10 所示，不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式，具有信号反射小，通讯成功率高等优点。

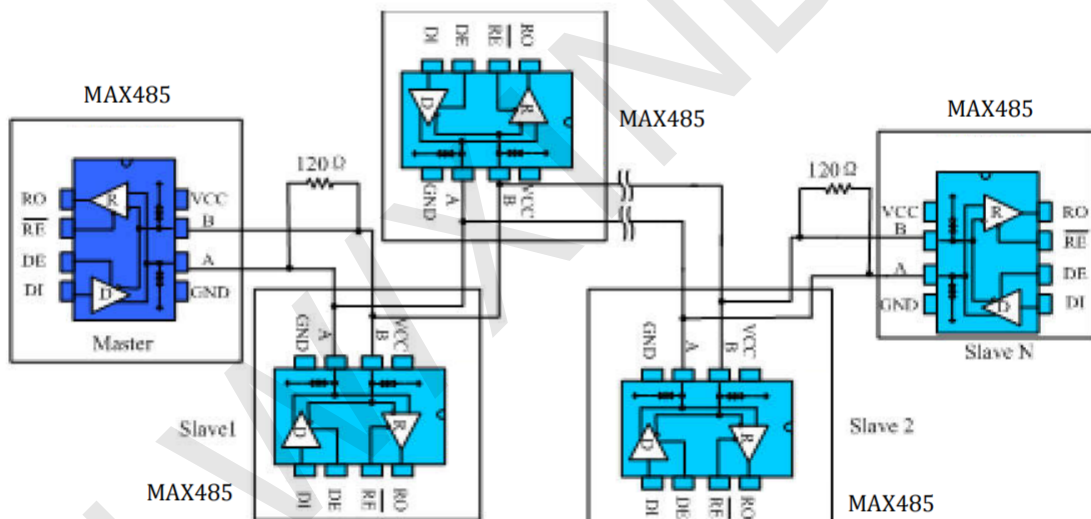
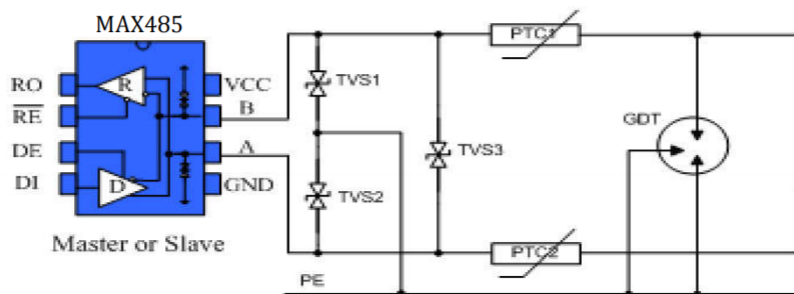


图10 手拉手式RS485 半双工通讯网络

总线端口防护：在恶劣的环境下，RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额 外的防护，甚至还需要做好防止380V 市电接入的方案，以避免智能仪表、工控主机的损坏。图11 为常见的3 种RS485 总线端口防护方案。第一种为AB 端口分别并联TVS 器件到保护地，AB 端口之间并联TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案；第二种为AB 分别并联TVS 到地、串联热敏电阻，AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案；第三种 为AB 分别接上下拉电阻到电源与地，AB 之间接TVS，A 或B 某一端口接热敏电阻的方案。



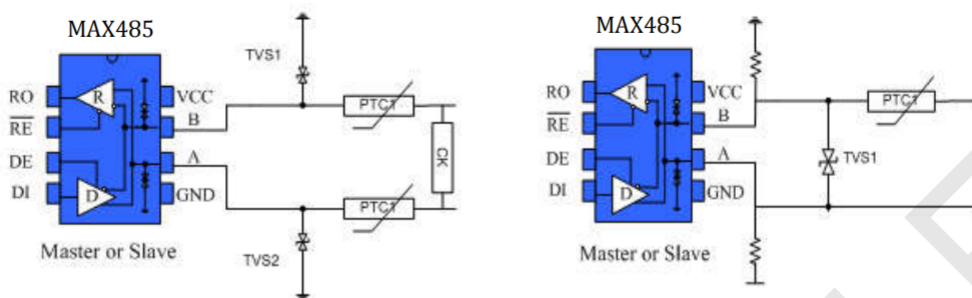
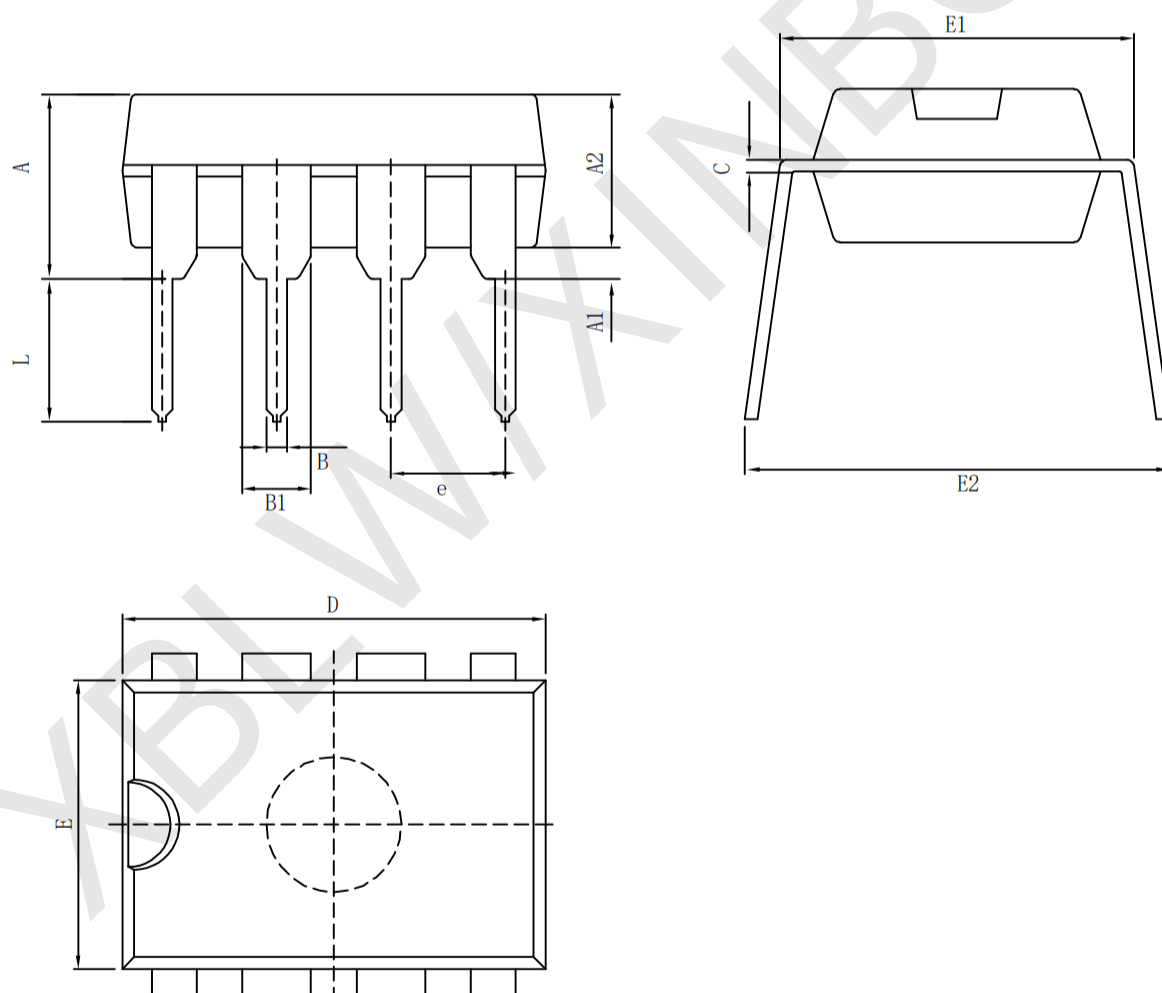


图 11 端口防护方案

Package Information

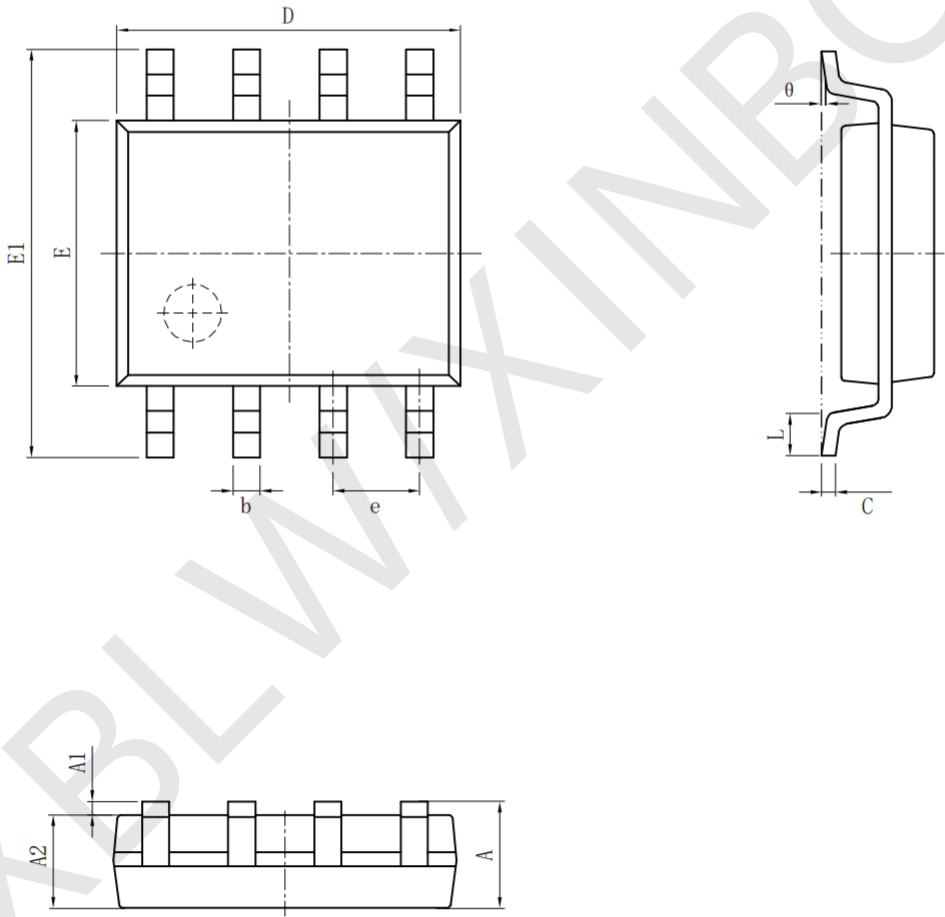
• DIP-8

Symbol	Size	Dimensions In Millimeters		Symbol	Size	Dimensions In Inches	
		Min (mm)	Max (mm)			Min (in)	Max (in)
A		3.710	4.310	A		0.146	0.170
A1		0.510		A1		0.020	
A2		3.200	3.600	A2		0.126	0.142
B		0.380	0.570	B		0.015	0.022
B1		1.524 (BSC)		B1		0.060 (BSC)	
C		0.204	0.360	C		0.008	0.014
D		9.000	9.400	D		0.354	0.370
E		6.200	6.600	E		0.244	0.260
E1		7.320	7.920	E1		0.288	0.312
e		2.540 (BSC)		e		0.100 (BSC)	
L		3.000	3.600	L		0.118	0.142
E2		8.400	9.000	E2		0.331	0.354



• SOP-8

Size Symbol	Dimensions In Millimeters		Size Symbol	Dimensions In Inches	
	Min(mm)	Max(mm)		Min(in)	Max(in)
A	1.350	1.750	A	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	A1	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	A2	0.053	0.061
b	0.330	0.510	b	0.013	0.020
c	0.170	0.250	c	0.006	0.010
D	4.700	5.100	D	0.185	0.200
E	3.800	4.000	E	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	E1	0.228	0.224
e	1.270(BSC)		e	0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	L	0.016	0.050
θ	0°	8°	θ	0°	8°



Statement:

- XBLW reserves the right to modify the product manual without prior notice! Before placing an order, customers need to confirm whether the obtained information is the latest version and verify the completeness of the relevant information.
- Any semi-guide product is subject to failure or malfunction under specified conditions. It is the buyer's responsibility to comply with safety standards when using XBLW products for system design and whole machine manufacturing. And take the appropriate safety measures to avoid the potential in the risk of loss of personal injury or loss of property situation!
- XBLW products have not been licensed for life support, military, and aerospace applications, and therefore XBLW is not responsible for any consequences arising from the use of this product in these areas.
- If any or all XBLW products (including technical data, services) described or contained in this document are subject to any applicable local export control laws and regulations, they may not be exported without an export license from the relevant authorities in accordance with such laws.
- The specifications of any and all XBLW products described or contained in this document specify the performance, characteristics, and functionality of said products in their standalone state, but do not guarantee the performance, characteristics, and functionality of said products installed in Customer's products or equipment. In order to verify symptoms and conditions that cannot be evaluated in a standalone device, the Customer should ultimately evaluate and test the device installed in the Customer's product device.
- XBLW documentation is only allowed to be copied without any alteration of the content and with the relevant authorization. XBLW assumes no responsibility or liability for altered documents.
- XBLW is committed to becoming the preferred semiconductor brand for customers, and XBLW will strive to provide customers with better performance and better quality products.